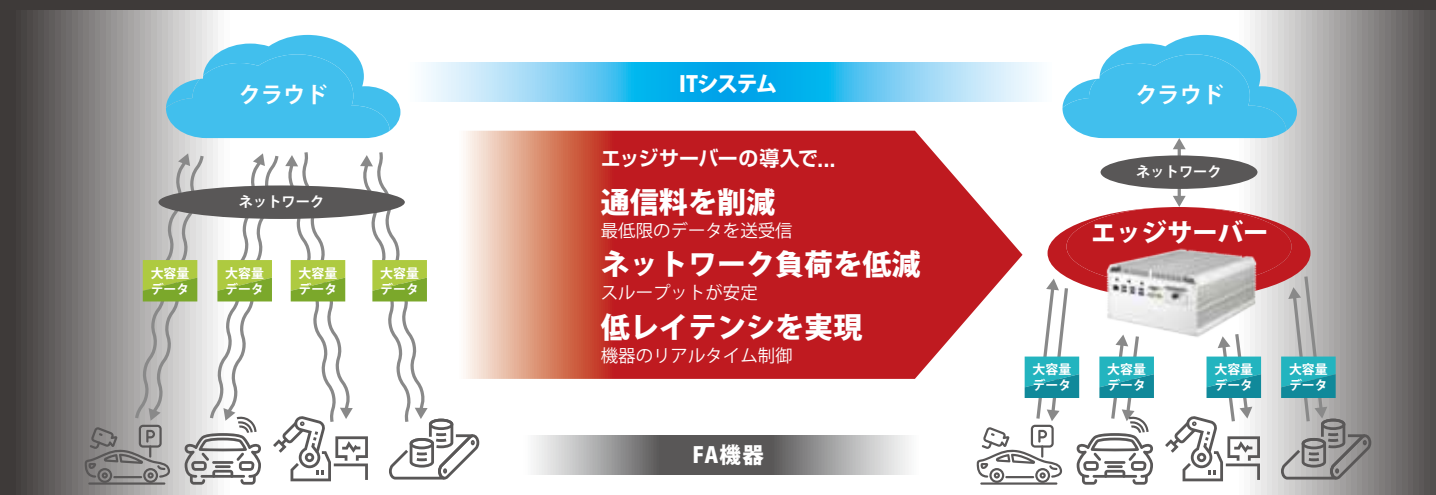


NVIDIA T4搭載、PoE×6・USB×5を装備 エッジAIコンピューティングプラットフォーム

☑ NVIDIA T4搭載のハイエンド小型エッジサーバー

ハイパフォーマンスコンピューティング、ディープラーニングのトレーニングと推論、機械学習、データ分析などに強いNVIDIA T4を搭載したハイエンド小型エッジサーバーは、クラウドで行っていた処理の一部をエッジで実行することにより、「レイテンシの向上」や「通信コストの削減」などを実現します。



☑ ハイエンドGPUを冷却し安定動作させる、優れた排熱機構

小型の筐体にパッシブ冷却のNVIDIA T4を実装するには、十分に排熱できるエアフローが必要です。GPUの温度が高くなると、サーマルスロットリングが働き、処理速度の低下を招くことがあります。EDG-INT4-G1Cは、NVIDIA T4から発生する熱を効率良く外気へと送り出すGPU用ブローファンとメッシュ構造の排熱口を実装することで、安定動作を可能にしています。



小型エッジサーバー EDG-INT4-G1C

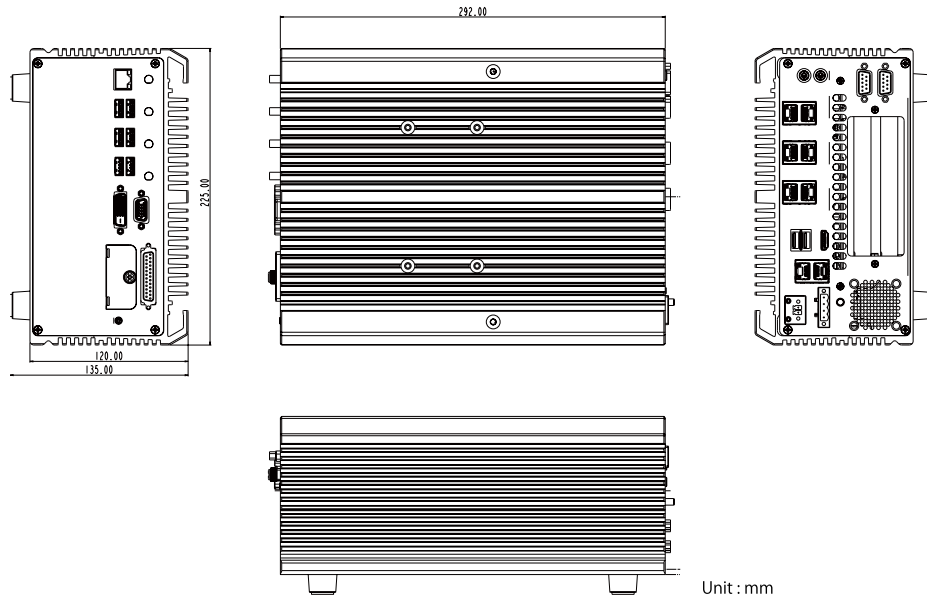


- Turing™世代GPU「NVIDIA® T4」搭載
- インテル®Xeon® W プロセッサー／
第10世代インテル® Core™ プロセッサー搭載
- インテル® W480Eチップセット装備
- PoEポート×6基、2.5GbE×1、1GbE×2基装備
- USB3.2×6基 (Gen2×2、Gen1×4)、
COMポート×2基装備
- 19V～36V DC-in
- 280W(24V)ACアダプター付属
- 16 DIO(8 DI、8 DO)装備

■製品仕様

モデル		EDG-INT4-G1C	EDG-INT4-G1C(短納期可能モデル)	
プロセッサ	種類	第10世代インテル® Core™ プロセッサー インテル® Xeon® Wプロセッサー	第10世代インテル® Core™ プロセッサー Core i7-10700TE (8コア16スレッド、2.00GHz、TDP35W)	
	搭載数	1		
チップセット		インテル® W480Eチップセット		
メモリー	規格	DDR4 2933 (i9/ i7 CPU)/2666(i5/ i3 CPU) SO-DIMM		
	容量	最大64GB	16GB	
	スロット数	2		
ストレージ	2.5"SSD	2 (内部)	SSD: 256GB	
	M.2	Key Bソケット		1 (2242/3052/2280)
		Key Eソケット		1 (2230)
GPU		NVIDIA T4		
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス		
I/O	シリアル (COM)	2 (RS-232/422/485)		
	USB	前面 2 (USB3.2, Gen2)、4 (USB3.2, Gen1) / 背面 2 (USB2.0)		
	HDMI	1		
	DVI	1		
	VGA	1		
	DIO	16 DIO(8 DI、8 DO) ※DB25コネクター		
	Ethernet (2.5GbE)	LAN 1 : インテル® WGI225LM 2.5GigE LAN		
	Ethernet (1GbE)	LAN 2 : インテル® WGI219LM GigE LAN、iAMT 14.0 LAN 3 : インテル® WGI211AT GigE LAN		
	PoE	LAN 4 : インテル® WGI211AT LAN 5 : インテル® WGI211AT LAN 6 : インテル® WGI211AT LAN 7 : インテル® WGI211AT LAN 8 : インテル® WGI211AT LAN 9 : インテル® WGI211AT		
	オーディオ	1 Mic-in、1 Line-out		
拡張スロット		Slot2 : PCI-Express x16 (Gen 3.0、x16シグナル) ※GPUで使用 Slot1 : PCI-Express x8 (Gen 3.0、x4シグナル) ※搭載するカードの仕様により制限があります。		
電源	入力電圧	19～36V、DC-in		
	電源入力タイプ	4ピンDC電源入力ターミナルブロック(リモート電源ON/OFFスイッチ)		
	イグニッションコントロール	2ピンターミナルブロック:IGN、GND		
	ACアダプター	280W ACアダプター 24V		
外観寸法 (W × L × H)		225mm×292mm×120mm (突起物等を除く)		
重量		約7.2kg		
取付方法		ウォールマウント用ブラケット (オプション)		
OS		－	Windows10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bit (日本語)	
利用環境	動作温度	0℃～+45℃		
	保存温度	-40℃～+85℃		
	湿度	10%～95% RH (結露なきこと)		
	耐衝撃性	MIL-STD-810G, Method 516.6,Table 516.6-II, 40G		
	耐振動性	MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4 w/ SSD		
	EMC指令	CE、FCC Class A		

■外観寸法



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2022年3月現在の内容です。